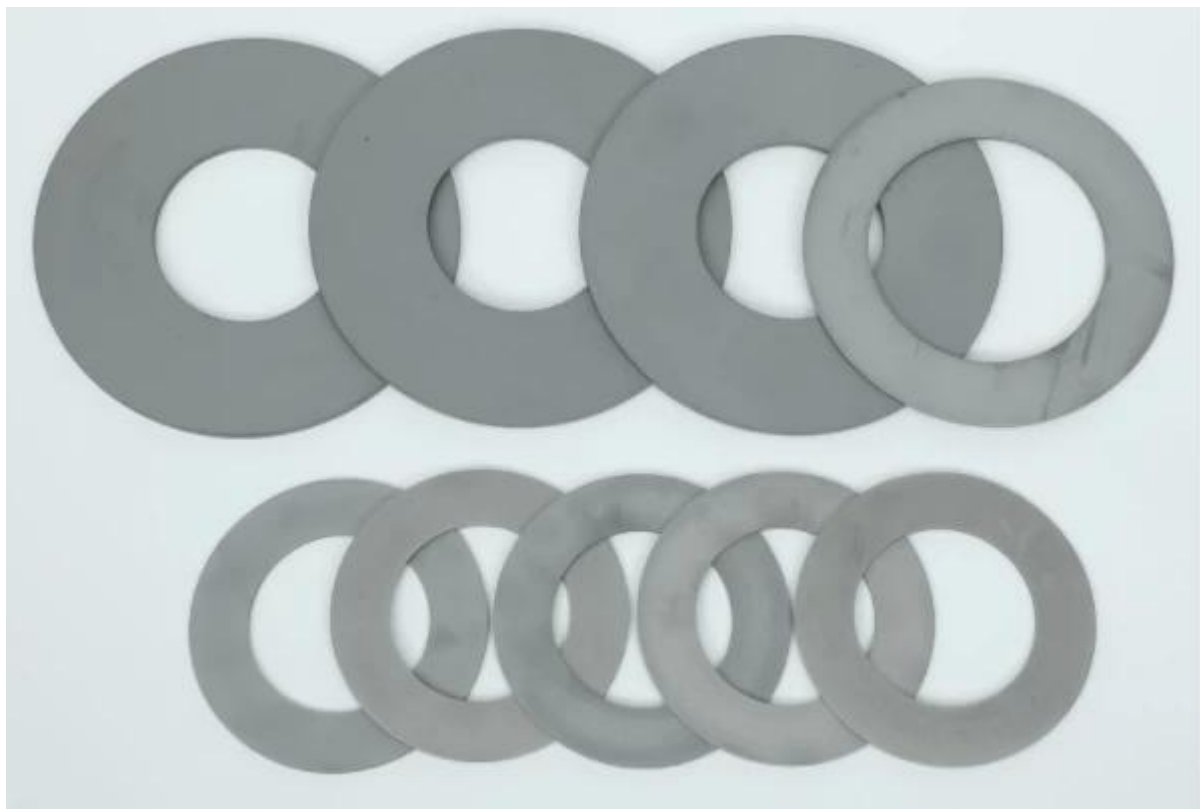


1. 晶粒度的测定方法：金相显微镜法、X射线衍射法、透射电镜法等。

2. 晶粒度的影响因素：冷却速度、合金成分、热处理工艺等。

3. 晶粒度的控制方法：控制冷却速度、添加晶粒细化剂、优化热处理工艺等。

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size ( $\mu\text{m}$ )	Density ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) $\pm 0.1$	Hardness (HRA) $\pm 0.5$	TRS ( $\text{kgf}/\text{mm}^2$ )
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	>350
H12U	88	12	0.4	14.25	92.5	>350
HG5	88	12	1.2	14.3	89	>280
HGF20	88.5	11.5	0.8	14.25	91	>320
HGF31	84	15	0.8	13.9	90.4	>350



4. 晶粒度的应用：材料性能优化、工艺控制、失效分析等。

1. 晶粒度的测定方法：金相显微镜法、X射线衍射法、透射电镜法等。

2. 晶粒度的影响因素：冷却速度、合金成分、热处理工艺等。

3. 1990 年 1 月 1 日起，凡在我国境内销售的产品，其包装物必须符合下列要求：

4. 1990 年 1 月 1 日起，凡在我国境内销售的产品，其包装物必须符合下列要求：

5. 凡在我国境内销售的产品，其包装物必须符合下列要求：